

**전기도금법으로 제조된 비스무스 텔루라이드의 열처리 효과에 따른 전기적 · 열전 특성 변화**

**Effect of Thermal Treatment on The Electrical and Thermoelectrical Properties of Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> Prepared by Electrodeposition**

이경환†, 이수, 이규환\*, 김동호\*, 김육중\*\*

국립창원대학교 화공시스템공학과; \*한국기계연구원 표면기술연구센터

\*\*한국기계연구원 에너지기계연구센터

### 1. 서론

경박단소화의 전기 · 전자산업의 발전은 새로운 냉각장치의 연구개발을 초래하였다. 이러한 냉각장치로 국부적 냉각도 가능한 열전소자(thermoelectric device)가 주목을 받아오고 있으며, 그 중 비스무스 텔루라이드(Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>)는 상온에서 가장 우수한 열전 특성(thermoelectrical properties)을 지닌 재료로 알려져 있다.[1] 본 연구에서는 전기도금법으로 Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>를 전착하고자 했다.

### 2. 실험

본 연구는 HNO<sub>3</sub> 수용액에 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>와 TeO<sub>2</sub>를 용해시켜 용액을 제조하고, 정전류법(Galvanostatic method)으로 Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>의 화학량론 비를 가지는 전류밀도를 조사하였다. 각각의 다른 농도를 가지는 용액(soln.B ; 3.75 mM Bi - 8.75 mM Te, soln.C ; 5 mM Bi + 7.5 mM Te)에 특정 전류밀도( $5 \times 10^{-3}$  A/cm<sup>2</sup>,  $2.5 \times 10^{-3}$  A/cm<sup>2</sup>)를 인가하여 Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> 조성비의 전착층을 제조하였다. 이후 열처리 온도에 따라 전기적 특성(carrier concentration, mobility and resistivity)과 열전 특성(seebeck coefficient, power factor =  $\alpha^2 \sigma$ ) 변화를 관찰하였다.

### 3. 결과

본 연구에서는 Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> 조성비의 전착층을 제조하였다. 제조된 Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>의 전착층은 열처리 온도에 따라 전기적 · 열전 특성 변화를 가졌다. 캐리어 농도는 열처리하기 전 약  $3 \times 10^{-21}$  cm<sup>-3</sup>에서 350 °C로 열처리한 후 약  $0.5 \times 10^{-21}$  cm<sup>-3</sup>로 감소하였으나, 이동도는 약  $9 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$ 에서  $47 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$ 으로 증가하였다. 제벡 계수 역시 열처리 온도가 증가함에 따라 350 °C에서 약  $-109.2 \mu\text{V/K}$ 로 약 2배 이상 증가하였으며, 열전성능인자는 약  $11.9 \times 10^2 \mu\text{W/K}^2 \text{m}$ 으로 약 4.5배 이상 증가하였다.

### 참고문헌

- [1] H. Scherrer, S. Scherrer, CRC Handbook of Thermoelectric, D. M. Rowe(Ed.), CRC Press, New York (1995) p211.